

长鑫存储内存芯片投产 国内存储迎突破

——电子行业周报

申港证券
SHENGANG SECURITIES

投资摘要:

市场回顾:

本周(2019.9.16-2019.9.20),上证指数下跌0.82%,深证成指下跌0.39%,创业板指下跌0.32%,申万电子指数上涨3.34%,位列申万28个一级行业涨跌幅榜第1位。

- ◆ 股价涨幅前五名分别是:五方光电、惠伦晶体、圣邦股份、大族激光、欣旺达;
- ◆ 股价跌幅前五名分别是:大港股份、弘信电子、华映科技、精研科技、亿纬锂能。

每周一谈:长鑫存储内存芯片投产 国内存储迎突破

20日在安徽合肥召开的2019世界制造业大会上,总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。

长鑫存储技术有限公司是中国第一家投入量产的DRAM芯片设计制造一体化企业,长鑫晶圆项目由合肥市产业投资(控股)集团有限公司和北京兆易创新科技股份有限公司合作投资,长鑫存储负责管理和运营,是中国大陆唯一拥有完整技术、工艺和生产运营团队的DRAM项目。

存储器(Memory)是电子系统的重要产品,用于数据的存储。随着大数据时代的到来,存储器的地位将更加突出。根据断电后数据是否会丢失,存储芯片可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片断电后数据会丢失,而非易失性存储芯片断电后数据能得到保留。

易失性存储芯片分为SRAM和DRAM:

- ◆ **SRAM:** 只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。其读写速度快,生产成本低,多用于容量较小的高速缓冲存储器。
- ◆ **DRAM:** 使用电容存储,为了保持数据,必须隔一段时间刷新一次。DRAM读写速度较慢,集成度高,生产成本低,多用于容量较大的主存储器。

非易失性存储芯片中最重要的是Flash芯片,主要分为NOR Flash和NAND Flash两种。

- ◆ **NOR Flash:** 主要用来存储代码及部分数据,是手机、PC、DVD、TV、USB Key、机顶盒、物联网设备等代码闪存应用领域的首选。
- ◆ **NAND Flash:** 可以实现大容量存储、高写入和擦除速度、相当擦写次数,多应用于大容量数据存储,例如智能手机、平板电脑、U盘、固态硬盘等领域。

目前全球存储市场主要被三星、SK海力士以及镁光等国外企业所垄断,特别是DRAM市场,这三家企业2017年占据全球95%以上市场份额,市场处于寡头垄断格局。

投资策略及组合: 存储芯片是半导体行业的重要组成部分,具有较高的技术壁垒。目前存储芯片国内暂时还处于相对落后状态,但近年已有不少公司取得相当大的突破,建议关注国内存储芯片龙头企业。推荐组合:兆易创新、北京君正、紫光国微、深科技、长电科技各20%。

风险提示: 行业发展不及预期;存储器需求低于预期;贸易战带来不确定影响。

评级

增持(维持)

2019年09月22日

曹旭特

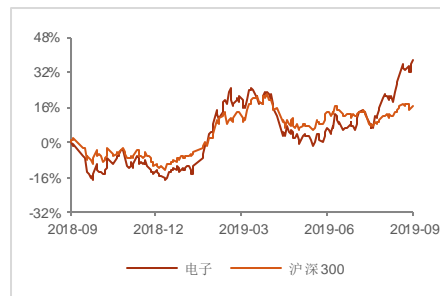
分析师

SAC执业证书编号:S1660519040001

行业基本资料

股票家数	248
行业平均市盈率	76.47
市场平均市盈率	17.51

行业表现走势图



资料来源:申港证券研究所

相关报告

- 1、《电子行业研究周报:半导体行业企稳回升 5G助力新发展》2019-09-16
- 2、《电子行业研究周报:从大基金入股精测电子看封测行业》2019-09-09
- 3、《电子行业点评:电子行业2019年年中点评》2019-09-02

1. 每周一谈：长鑫存储内存芯片投产 国内存储迎突破

1.1 长鑫存储 10nm 级 8Gb DDR4 首度亮相

20 日在安徽合肥召开的 2019 世界制造业大会上，总投资约 1500 亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产，其与国际主流 DRAM 产品同步的 10 纳米级第一代 8Gb DDR4 首度亮相，一期设计产能每月 12 万片晶圆。

该项目以打造设计和制造一体化的内存芯片国产化制造基地为目标，2016 年 5 月由合肥市政府旗下投资平台合肥产投与细分存储器国产领军企业兆易创新共同出资组建，是安徽省单体投资最大的工业项目。目前，项目已通过层层评审，并获得工信部旗下检测机构中国电子技术标准化研究院的量产良率检测报告。

合肥长鑫存储董事长兼首席执行官朱一明表示，“投产的 8Gb DDR4 通过了多个国内外大客户的验证，今年底正式交付，另有一款供移动终端使用的低功耗产品也即将投产。”

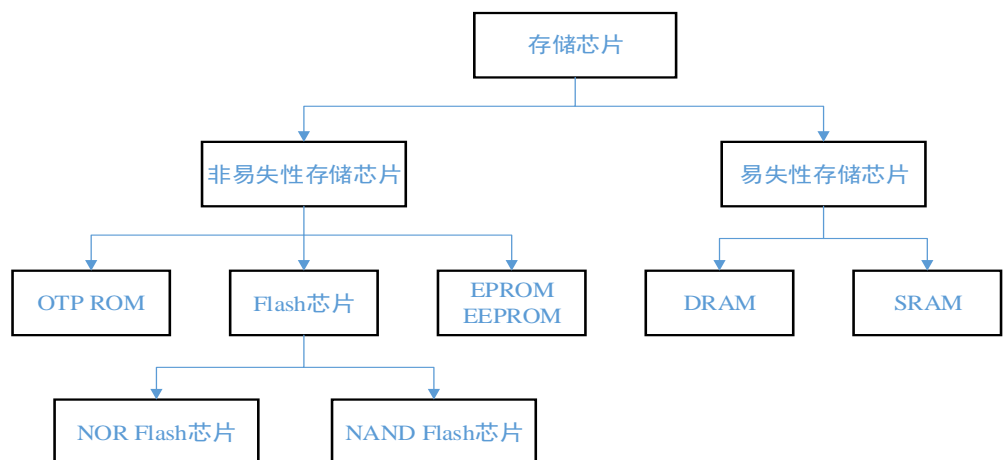
长鑫存储技术有限公司是中国第一家投入量产的 DRAM 芯片设计制造一体化企业，长鑫晶圆项目由合肥市产业投资（控股）集团有限公司和北京兆易创新科技股份有限公司合作投资，长鑫存储负责管理和运营，是中国大陆唯一拥有完整技术、工艺和生产运营团队的 DRAM 项目。

1.2 存储芯片分类

存储器（Memory）是电子系统的重要产品，用于数据的存储。随着大数据时代的到来，存储器的地位将更加突出。

根据断电后数据是否会丢失，存储芯片可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片断电后数据会丢失，而非易失性存储芯片断电后数据能得到保留。

图1：存储芯片分类



资料来源：兆易创新，申港证券研究所

易失性存储芯片分为静态随机存取存储器（Static Random-Access Memory, SRAM）

和动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory, DRAM）。

- ◆ **SRAM:** 所谓的“静态”，是指这种存储器只要保持通电，里面储存的数据就可以恒常保持。当电力供应停止时，SRAM 储存的数据还是会消失。SRAM 读写速度快，生产成本低，多用于容量较小的高速缓冲存储器。
- ◆ **DRAM:** DRAM 使用电容存储，为了保持数据，必须隔一段时间刷新（refresh）一次，如果存储单元没有被刷新，存储的信息就会丢失。当电力供应停止时，DRAM 储存的数据也会消失。DRAM 读写速度较慢，集成度高，生产成本低，多用于容量较大的主存储器。

表1: SRAM 与 DRAM 比较

	SRAM	DRAM
存储信息	触发器	电容
破坏性读出	非	是
需要刷新	不要	需要
送行列地址	同时送	分两次送
运行速度	快	慢
集成度	低	高
发热量	大	小
存储成本	高	低

资料来源：互联网整理，申港证券研究所

非易失性存储芯片可分为一次可编程只读存储器（One Time Programming ROM, OTPROM）、Flash 芯片、可擦除可编程只读存储器（Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM）以及带电可擦除可编程只读存储器（Electrically Erasable Programmable read only memory, EEPROM）。

非易失性存储芯片中最重要的是 Flash 芯片，主要分为 NOR Flash 和 NAND Flash 两种。

- ◆ **NOR Flash:** 主要用来存储代码及部分数据，是手机、PC、DVD、TV、USB Key、机顶盒、物联网设备等代码闪存应用领域的首选。NOR Flash 分为串行和并行。串行结构相对简单、成本更低，随着工艺的进步，串行闪存已经能满足一般系统对速度及数据读写的要求，逐步成为主要系统方案商的首选。
- ◆ **NAND Flash:** 可以实现大容量存储、高写入和擦除速度、相当擦写次数，多应用于大容量数据存储，例如智能手机、平板电脑、U 盘、固态硬盘等领域。

1.3 市场情况

根据 WSTS 统计，2017 年全球半导体行业销售额为 4382 亿美元，存储器行业营收达到 1319 亿美元，占半导体行业收入的 30.1%，过去五年（2012-2017）年复合增长率高达 37%。其中 DRAM 市场规模 730 亿美元，NAND 市场规模 540 亿美元，NOR 市场规模 23 亿美元。

2017 年，受益于 DRAM 规模的快速增长，存储市场销售额占全球半导体销售额比例大幅提升，由 2016 年的 22.6% 提升至 2017 年的 30.1%。2018 年这一比例估计

将达到 33.8%。2019 年受 DRAM 市场价格暴跌影响，预计占比会有所下降。

图2：存储器占比不断提升



资料来源：WSTS，申港证券研究所

2017 年全球 DRAM 市场规模 730 亿美元，前三位生产商三星、SK 海力士以及镁光合计占据全球 95% 以上市场份额，DRAM 市场处于全球寡头垄断格局。

2017 年全球 NAND Flash 市场规模 540 亿美元，三星占比 39% 排名第一，东芝西部数据合计占比 32%。

2017 年全球 NOR Flash 市场规模 23 亿美元，市占率前四位分别为镁光、旺宏电子、赛普拉斯半导体和华邦电子，国内兆易创新全球销售额排名第五，市占率为 10.5%。在串行 NOR Flash 产品市场，兆易创新全球销售额排名为第三位，前二位分别为华邦电子、旺宏电子。

1.4 国内存储主要上市公司

存储芯片是在半导体行业中有着极其重要的地位，近年来约占全球半导体行业总销售额的三分之一。目前存储芯片国内暂时还处于相对落后状态，但近年已有不少公司取得相当大的突破。

兆易创新

公司是国内闪存芯片龙头企业，公司闪存芯片产品主要为 NOR Flash 和 NAND Flash 两类。1) NOR Flash 即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及部分数据。公司 NOR Flash 产品广泛应用于 PC 主板、数字机顶盒、路由器、家庭网关、安防监控产品、智能家电产品、汽车等。2) NAND Flash 即数据型闪存芯片，公司 NAND Flash 产品属于 SLC NAND，广泛应用于网络通讯、语音存储、智能电视、工业控制、机顶盒、打印机、穿戴式设备等。

2017 年公司闪存产品全球销售额排名第十位。在 NOR Flash 市场，公司的全球销售额排名为第五位，市场占有率为 10.5%，前四位分别为美光、旺宏电子、赛普拉斯半导体和华邦电子。在串行 NOR Flash 产品市场，公司全球销售额排名为第三位，前二位分别为华邦电子、旺宏电子。

北京君正

公司为集成电路设计企业，拥有全球领先的 32 位嵌入式 CPU 技术和低功耗技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等产品及整体解决方案的研发和销售。

公司拟作价 72 亿元收购北京矽成 100% 的股份，其中，约 56 亿元采用股份支付、16 亿元的对价采用现金支付。北京矽成控股的 ISSI 是全球车载储存芯片的龙头厂商，其 DRAM 位居全球第七、SRAM 位居全球第二，是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级 RAM 芯片的企业。

紫光国微

公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由紫光同芯微电子有限公司（简称“同芯微电子”）、深圳市国微电子有限公司（简称“国微电子”）和西安紫光国芯半导体有限公司（简称“西安紫光国芯”）三个核心子公司承担。

2019 年上半年度，公司 DRAM 存储器芯片和内存模组系列产品继续在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面出货保持稳定，在国产计算机应用市场稳定增长。公司内嵌 ECC DRAM 存储器产品，在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域供货稳定，DDR4 模组等产品实现小批量销售，新开发的产品和方案进展顺利。专用集成电路设计和测试服务业务积极拓展集团内部客户，业务规模稳定。

1.5 投资建议

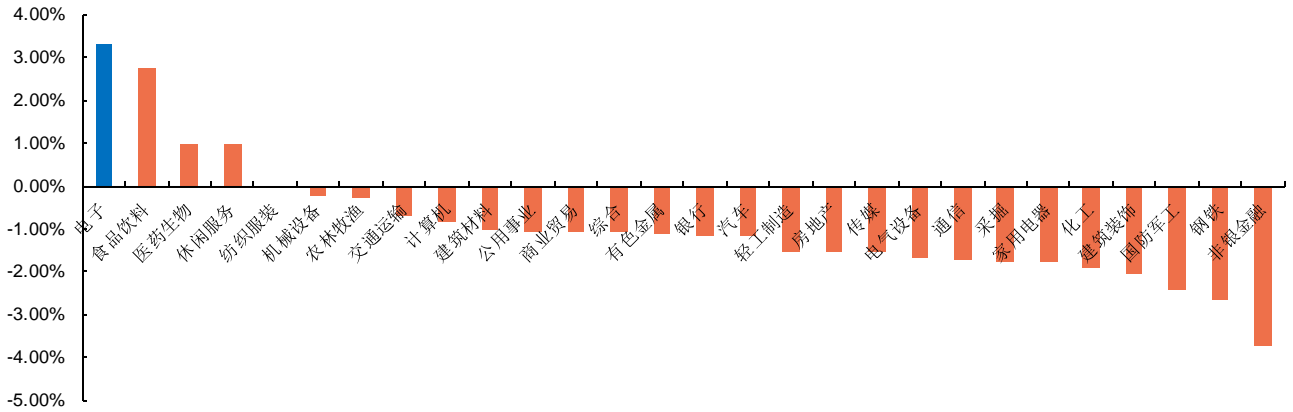
存储芯片是半导体行业的重要组成部分，具有较高的技术壁垒。目前存储芯片国内暂时还处于相对落后状态，但近年已有不少公司取得相当大的突破。建议关注国内存储芯片龙头企业兆易创新、北京君正、紫光国微等。

2. 市场回顾

本周（2019.9.16-2019.9.20），上证指数下跌 0.82%，深证成指下跌 0.39%，创业板指下跌 0.32%，申万电子指数上涨 3.34%，位列申万 28 个一级行业涨跌幅榜第 1 位。目前，电子板块 TTM 市盈率为 39.9 倍，位列申万 28 个一级行业的第 4 位。

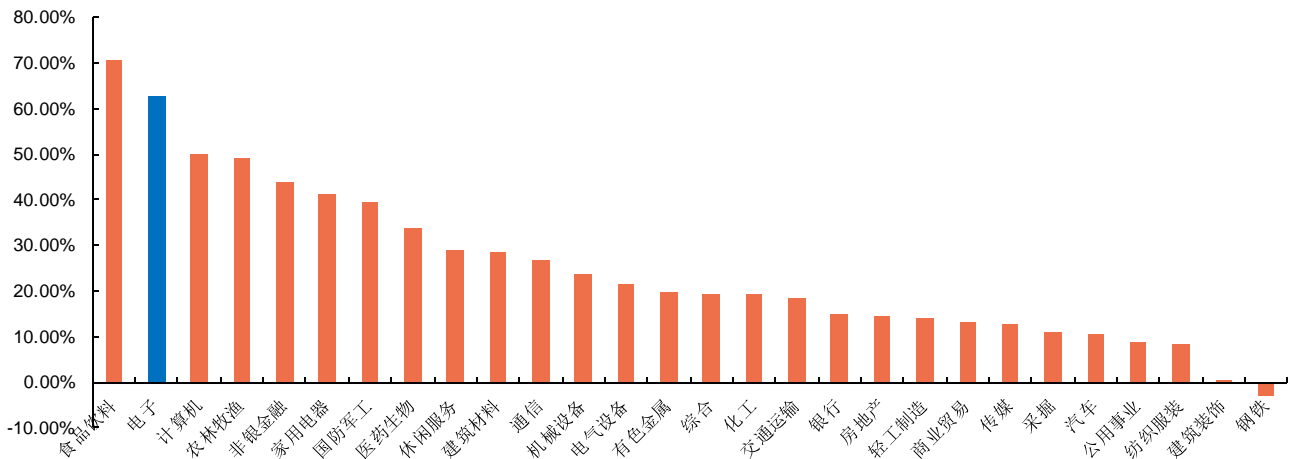
自 2019 年初至今，上证综指、深证成指、创业板指、申万电子指数分别上涨 20.55%、36.49%、36.35%、62.79%，电子指数在申万一级行业排名涨跌幅第 2 名。

图3: 申万一级行业指数周涨跌幅



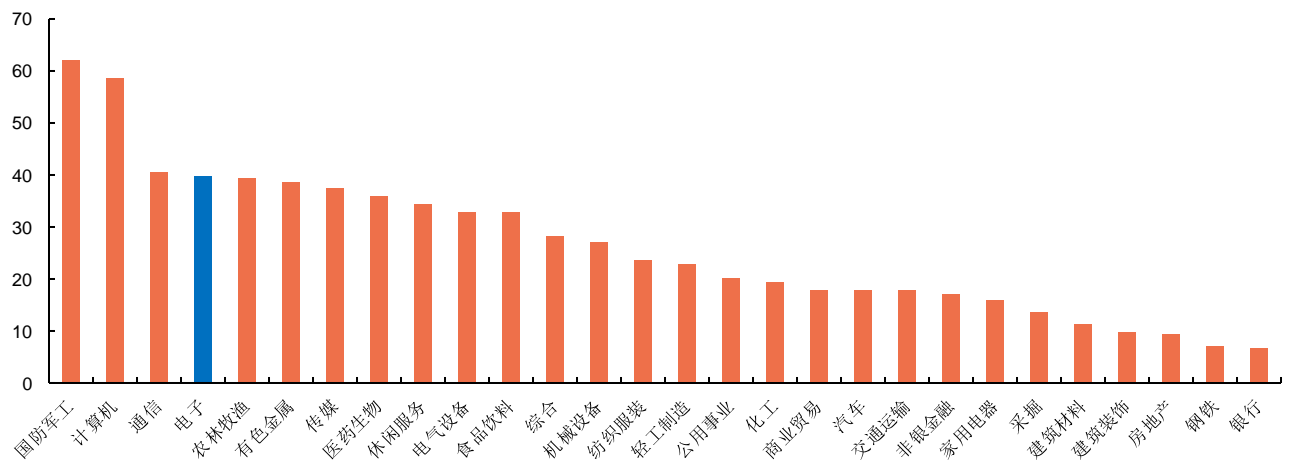
资料来源: wind, 申港证券研究所

图4: 申万一级行业年初至今涨跌幅对比



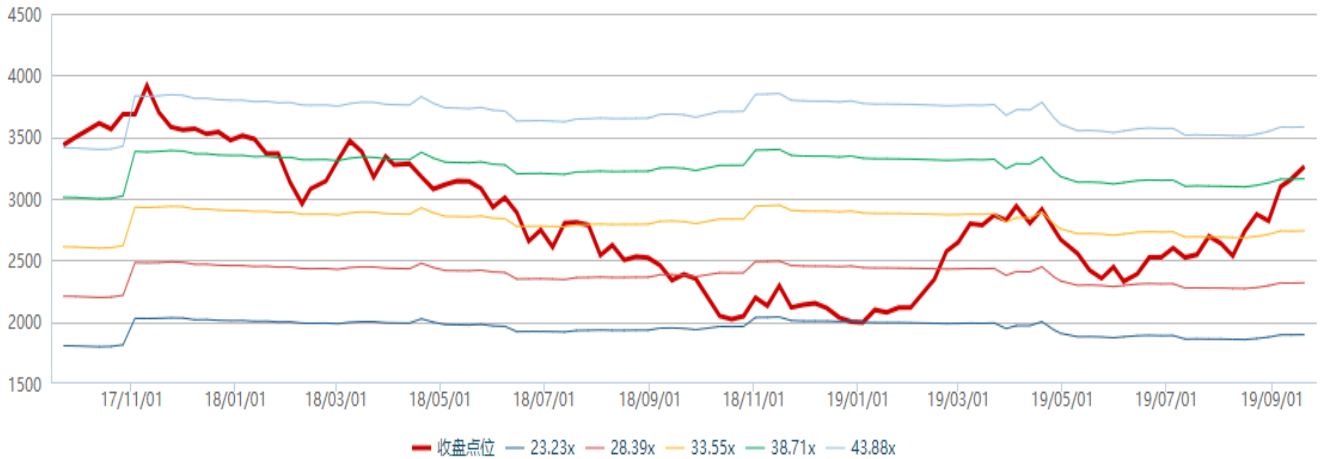
资料来源: wind, 申港证券研究所

图5: 申万一级行业 PE (TTM) 对比



资料来源: wind, 申港证券研究所

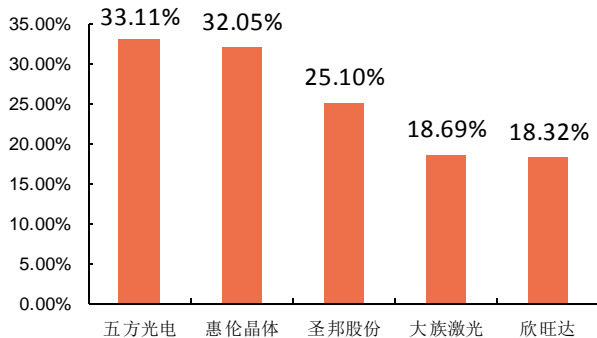
图6: 电子行业估值水平(PE-TTM)



资料来源: wind, 申港证券研究所

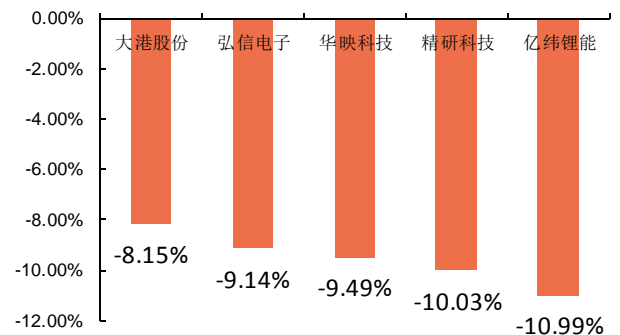
个股方面, 本周涨幅前五的股票是五方光电、惠伦晶体、圣邦股份、大族激光和欣旺达; 跌幅靠前的是大港股份、弘信电子、华映科技、精研科技和亿纬锂能。

图7: SW 电子成分本周涨幅前 5



资料来源: wind, 申港证券研究所

图8: SW 电子成分本周跌幅前 5



资料来源: wind, 申港证券研究所

3. 行业新闻

3.1 半导体

台积电向应用材料等公司订购价值约 13 亿元设备。9月19日消息, 台湾地区半导体制造商台积电日前发布公告称, 向应用材料等公司订购价值新台币 56.68 亿元 (约合人民币 13 亿元) 设备。台积电未披露订购机器设备具体名称。交易对象分别为 Lam Research International Srl, Applied Materials (应用材料) South East Asia Pte. Ltd., IMS Nanofabrication AG, ASML。

长鑫存储宣布其设计产能 12 万片生产线投产。新华社消息, 在合肥召开的 2019 世界制造业大会上, 总投资约 1500 亿元的长鑫存储内存芯片制造项目宣布投产, 其与国际主流 DRAM 产品同步的 10 纳米级第一代 8Gb DDR4 首度亮相, 一期设计产能每月 12 万片晶圆。该项目 2016 年 5 月由合肥市政府旗下合肥产投与兆易创新共同出资组建。目前, 项目已获得工信部旗下检测机构中国电子技术标准化研究

院的量产良率检测报告。长鑫存储董事长兼首席执行官朱一明介绍，长鑫存储投产的 8Gb DDR4 通过了多个国内外大客户的验证，今年底正式交付，另有一款供移动终端使用的低功耗产品也即将投产。

意法半导体推出低失真高压 LED 驱动器。近日，意法半导体发布 HVLED007 AC / DC LED 驱动器，采用新的失真抑制输入电流整形 (ICS) 电路，使节能型固态灯具符合日益严格的照明规定。HVLED007 是一个峰值电流模式 PFC 控制器，为隔离式高功率因数准谐振反激式转换器专门设计，ICS 电路确保电网输入电流是真正的正弦交变电流，在整个负载和输入电压范围内，输入电流总谐波失真 (THD) 极低，在满负荷时低于 5%。功率因数接近 1，最高能效高于 90%，HVLED007 允许设计人员仅用一个控制 IC 驱动多个高达 80W 的中高功率 LED 照明灯具。

高通 31 亿美元收购 TDK 在射频前端合资公司 RF360 的股份。高通当地时间周一宣布，将斥资 31 亿美元收购 TDK 公司在射频前端(RFFE)技术合资企业 RF360 Holdings 中的剩余股权，这笔交易将让高通把 RFFE 技术完全整合到下一代 5G 解决方案中。高通将获得 RF360 Holdings 所有工程师和知识产权。拥有 RF360 Holdings，在开发将蜂窝调制解调器与天线连接起来的 RFFE 部件方面，高通的能力将提到加强。高通上月表示，将其部件紧密地集成到 Snapdragon Modem-RF 系统，客户就可以购买带有 Snapdragon 处理器、5G 调制解调器、射频前端和天线的集成体，从而生产出更节能的设备。这笔交易意味着，高通公司将能够为包括功率放大器、滤波器、天线调谐器、低噪声放大器、交换机和包络跟踪器在内的 6 GHz 以下及毫米波段设备，提供完整的端到端 5G 解决方案。

华虹无锡厂一期 12 英寸产线建成投产。随着首批 12 英寸硅片进入工艺机台，开始 55 纳米芯片产品制造，华虹半导体(无锡)有限公司(华虹七厂)作为华虹集团在上海市域以外的第一个项目投入量产。华虹半导体(无锡)有限公司一期工程工艺技术平台覆盖移动通信、物联网、智能家居、人工智能、新能源汽车等新兴应用领域。华虹无锡项目的建成投产，在成为全国最先进的特色工艺生产线的同时，也是全国首条量产的 12 英寸功率器件代工生产线。目前在上海和无锡华虹共投产了 3 条 8 英寸、2 条 12 英寸生产线。华虹表示，还将适时在无锡建二期工厂和三期工厂，而届时制造工艺节点也将同步提升，三期全部建成后华虹在无锡将有 3 条 12 英寸生产线。

粤芯 12 英寸晶圆项目投产。9 月 20 日，粤芯 12 英寸晶圆项目在黄埔区、广州开发区正式投产。这是广州第一条、广东省首条量产的 12 英寸芯片生产线，其顺利投产标志着广州先进制造业“缺芯”成为历史。该项目从打桩施工到投产只用了一年半，建设期间汇聚了近 70 家上下游企业，为广深港澳科创走廊补足了重要的高端产业短板。营商加速度、产业加速度和创新加速度的三重叠加，彰显广东迈向高质量发展的澎湃动力。

总投资 30 亿元的龙芯中科南方总部项目落户南京。据南京软件园报道，9 月 18 日，2019 中国南京金秋经贸洽谈会重大项目集中签约仪式举行，6 个重大项目签约落户南京软件园，项目总投资达 100 亿元，涵盖 5 个半导体产业相关项目。这 5 个半导体相关项目为龙芯中科南方总部项目、大鱼半导体物联网芯片总部项目、创天人工智能芯片设计项目、创芯慧联芯片研发项目。其中龙芯中科南方总部项目签约落户，是龙芯中科在南方区域的重大战略布局，也是江北新区支持集成电路等自主创新产业发展、发力的重要战略举措。该总部项目拟投资 30 亿元，用地约 200 亩，建设

龙芯自主创新产业园，开展新型信息技术相关产业的研发、生产和销售，吸引上下游企业入驻该自主创新产业园，促成产业间的互相需求与共识，促进以龙芯为核心的自主创新产业生态在江北新区实现良性发展。

3.2 消费电子

IDC：第二季度中国可穿戴设备市场出货量同比增 34.3%。9月19日消息，IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2019年第二季度》显示，2019年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307万台，同比增长34.3%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为1846万台，同比增长31.9%，智能可穿戴设备出货量为461万台，同比增长45.0%。2019年第二季度中国可穿戴设备市场中，耳机设备的出货量为745万台，同比增长113%，占比达到32%，创历史新高。随着前三大厂商——小米、华为和苹果在可穿戴市场上的竞争逐渐白热化，耳机设备的出货在互相角逐中显得越发重要。

华为全球发布 Mate30 系列：超级智慧 近在咫尺。9月19日，华为在德国慕尼黑举办的新品发布会上，正式推出了华为 Mate30 系列智能手机，硬件配置超级豪华，搭载全新 88° 超曲面环幕屏、麒麟 990 系列处理器、徕卡电影四摄等。华为 Mate30 为直屏设计，6.62 英寸 OLED 屏幕，2340x1080 分辨率，支持 DCI-P3 HDR，整机三围 160.8mm x 76.1mm x 8.4mm，196g，具备 IP53 防尘防水能力。华为 Mate30 Pro 则搭载了 88° 超曲面 OLED 环形屏幕，两侧无边框设计，6.53 英寸 OLED 显示屏分辨率达到了 2400x1176，覆盖 DCI-P3 广色域，三围尺寸为 158.1mm x 73.1mm x 8.8mm，重 198g，升级至 IP68 防尘防水。

Qorvo 推出全球首款双频 Wi-Fi 6 前端模块。9月18日，移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo 宣布推出全球首款双频 Wi-Fi 6 前端模块 (FEM)。这款新 FEM 非常适合 Wi-Fi 6 用户端设备 (CPE)，它将提供 HD / 4K 视频所需的性能和物联网 (IoT) 所需的效率集合在一起。Wi-Fi 6 (802.11ax) 代表了 Wi-Fi 的下一波发展，它支持单个用户对流量更高的需求、单个接入点对接更多用户、增强的蜂窝式减负、更高密度的部署，以及额外的功率和性能。

艾迈斯半导体推出了全球体积最小的数字红外接近传感器模块。9月16日，艾迈斯半导体宣布推出了全球体积最小的数字接近传感器模块——TMD2635，其超小封装体积仅为 1mm³，让生产真正无线立体声 (TWS) 耳塞产品的音频制造商们得以开发更小、更轻的工业设计耳塞。红外接近传感器可以实现无线耳机入耳 / 出耳检测，帮助延长电池单次充电后的使用时间，且可以与另一个 TMD2635 一起使用，实现基本的无触摸手势控制，无需采用按钮。

集成 1024 颗昇腾 910 华为发布全球最快 AI 训练集群 Atlas 900。9月18日，华为全连接大会开幕，AI 产品 Atlas 900 正式发布。华为轮值董事长胡厚崑称其为“全球最快的 AI 训练集群”。Atlas 900 由数千颗昇腾 910 组成，算力能达 256~1024 PFLOPS@FP16。训练 ResNet-50 只用了 59.8 秒的集群规模，用到了 1024 颗昇腾 910。

4. 重点公司动态

紫光控股 9.9 亿港元出售 67.82%股份。紫光控股于 17 日公告，公司接到公司控股股东紫光科技战略投资有限公司通知，其于当日与芯鼎及北京紫光资本订立股份购买协议，芯鼎（其与中青芯鑫简称“联合要约人”）同意以对价 9.9 亿港元（相对于每股约 1 元港币），有条件地向其收购股份。本次交易完成后，联合要约人及其一致行动人（包括上海半导体装备材料基金及河南战兴基金）将持有 9.87 亿股及权益，约占公司总股本的 67.82%。

TCL 集团累计回购 3.57%公司股份 斥资 16.4 亿元。9 月 18 日消息，半导体显示技术公司 TCL 集团(SZ:000100)今晚发布了关于回购公司股份的回购进展公告。TCL 集团累计回购 3.57%公司股份，斥资 16.4 亿元。公告显示，截至 2019 年 9 月 18 日，TCL 集团已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计 483,810,522 股，占公司总股本的 3.57%，最高成交价为 4.17 元/股，最低成交价为 3.13 元/股，成交均价为 3.40 元/股，成交总金额为 1,643,683,898.72 元（不含交易费用）。

深天马 A 累计新增借款超过 2018 年末净资产 20%。9 月 17 日消息，深交所上市公司、半导体显示技术公司深天马 A(SZ:000050, 天马微电子)今日发布公告称，累计新增借款超过 2018 年末净资产 20%。深天马 A 表示，公司 2019 年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年年末的净资产及借款余额为经审计的合并口径数据外，其余数据均为未经审计的合并口径数据。

通富微电大股东计划减持不超过 1%公司股份。9 月 16 日消息，深交所上市公司通富微电(SZ:002156)今晚发布公告称，持通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 57,685,229 股（占公司总股本比例 5.00%）的股东南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 90 天内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 11,537,045 股（即不超过公司股份总数的 1%）。

京东方称重庆第六代柔性 AMOLED 生产线已开工建设。9 月 16 日消息，深交所上市公司京东方今日在深交所互动易平台上表示，公司重庆第六代柔性 AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）生产线已开工建设，预计 2021 年投产。京东方于去年 3 月公告了此项目，总投资 465 亿元，主要产品定位为 AMOLED 高端手机显示及新兴移动显示产品。当时公告介绍称，该项目公司名称为重庆京东方显示技术有限公司；主要产品：手机、车载及可折叠笔记本等柔性显示产品；玻璃基板尺寸：1,500mm × 1,850mm；设计产能：48K/月；项目建设周期：28 个月。

闻泰科技资产重组新进展 合计持合肥中闻金泰 100%股权。9 月 18 日，闻泰科技公布，根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准，公司将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司 Nexperia Holding B.V.（“安世集团”）的间接控制。根据本次交易方案，合肥中闻金泰半导体投资有限公司（“合肥中闻金泰”）作为本次交易的标的公司之一，公司拟通过发行股份的方式收购云南省城市建设投资集团有限公司（“云南省城投”）、西藏风格投资管理有限公司（“西藏风格”）、西藏富恒投资管理有限公司（“西藏富恒”）、上海鹏欣智澎

投资中心(有限合伙) (“鹏欣智澎”)、无锡国联集成电路投资中心(有限合伙) (“国联集成电路”)、珠海格力电器股份有限公司 (“格力电器”)、深圳市智泽兆纬科技有限公司 (“智泽兆纬”) 合计持有的合肥中闻金泰 54.51% 的股权。

5. 风险提示

行业发展不及预期；存储器需求低于预期；贸易战带来不确定影响。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由申港证券股份有限公司研究所撰写，申港证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供申港证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

申港证券行业评级体系：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5% 以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

市场基准指数为沪深 300 指数

申港证券公司评级体系：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15% 以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上